**附件**

# 第十一届全国高校材料学科研究生凌峰论坛参会回执

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **性别** |  | **学校所在地** | **省 市** |
| **学校** |  | **学院专业** |  | | |
| **类别** | **□硕士 □博士** | **年级** |  | **联系电话** |  |
| **通讯地址** |  | | | | |
| **研究方向分类** | **□无机非金属材料 □金属材料 □能源材料**  **□高分子材料 □生物材料 □其他** | | | | |
| **研究方向（具体）** |  | | | | |
| **口头报告题目** |  | | | | |
| **口头报告摘要** | **（可附页）** | | | | |

**说明：**

1、请于**2023年11月10日19:00前**将该回执通过**E-mail:lingfengluntan@163.com**，逾期未回复将视同放弃参会，word文件和邮件主题统一命名为“**学校+研究方向+姓名+参会回执**”。

2、论坛信息发布网站：**http://cm.xmu.edu.cn**，请注意网站发布的论坛信息。

3、组委会联络人：尹美（电话：14779595856 邮箱：[20720221150085@stu](mailto:20720221150085@xmu.stu). xmu. edu.cn)